

「つなぐ」技術で課題解決！

## 導電性Ni-P微粒子 (ニッケル-リン)



### 特長

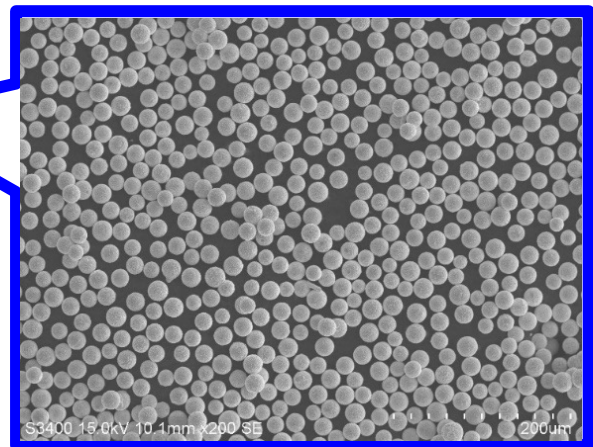
- ・高い真球度と均一な粒径
- ・各種めっきによる低抵抗化
- ・Ni-P粒子コアによる耐熱性・高硬度

### 用途

- ・チップレット2.5G実装部材
- ・ダイアタッチペースト用ギャップ材
- ・異方性導電フィルム用導電粒子

### ■ Ni-P微粒子めっき品の外観とSEM像

高い真球状・平滑な表面・単分散・均一な粒径サイズ(1~30 $\mu$ m)を保有



### ■ Ni-P微粒子の特性

各種めっきにより「低抵抗」「金属結合」「耐食性」など 様々な機能を付与

| めっき種類                                      | なし<br>None | 金<br>Au | 銀<br>Ag | 銅<br>Cu | はんだ<br>Sn-Bi  |
|--------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| 体積抵抗率( $\times 10^{-5} \Omega \cdot m$ )※1 | 21.1       | 0.6     | 0.13    | 0.07    | 0.5※2         |
| 融点(℃)                                      | -          | -       | -       | -       | $\approx 140$ |

※1 体積抵抗率は、粒径・めっき膜厚・接合状態により変化します ※2 はんだの体積抵抗率は、はんだ付け前の値です

問合せ窓口

株式会社プロテリアル

特殊銅事業部 電子材部  
東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア

本カタログに記載の特性値、写真、図表、順位、評価等は当社試験データによる代表的な値であり、製品の品質を保証するものではありません。本カタログの記載内容は予告なく変更することがございます。

